

2026-2031年中国半导体材料市场研究与投资前景预测报告

报告简介

半导体材料可按化学组成来分，再将结构与性能比较特殊的非晶态与液态半导体单独列为一类。按照这样分类方法可将半导体材料分为元素半导体、无机化合物半导体、有机化合物半导体和非晶态与液态半导体。相对于半导体设备市场，半导体材料市场长期处于配角的位置，但随着芯片出货量增长，材料市场将保持持续增长，并开始摆脱浮华的设备市场所带来的阴影。如果不计算键合线，封装材料市场的规模则同比增长4%以上；键合线材质持续从金(Au)过渡到铜(Cu)抑制了封装材料市场的增长。由于拥有庞大的代工企业及先进的封装基地，中国台湾连续5年位居全球半导体材料消费榜首，总额达98亿美元；北美地区位居第二，同比增长5%；其次是中国、韩国和欧洲；日本和其他国家(地区)半导体材料市场规模与上年持平。日本保持最大半导体材料市场的地位。然而台湾、ROW、韩国也开始崛起成为重要的市场，材料市场的崛起体现了器件制造业在这些地区的发展。晶圆制造材料市场和封装材料市场双双获得增长，未来增长将趋于缓和，但增长势头仍将保持。

半导体材料及应用已成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志。从目前电子工业的发展来看，尽管有各种新型的半导体材料不断出现，半导体硅材料以丰富的资源、优质的特性、日臻完善的工艺以及广泛的用途等综合优势而成为了当代电子工业中应用最多的半导体材料。硅是集成电路产业的基础，半导体材料中98%是硅。半导体器件的95%以上是用硅材料制作的，90%以上的大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)、甚大规模集成电路(ULSI)都是制作在高纯优质的硅抛光片和外延片上的。硅片被称作集成电路的核心材料，硅材料产业的发展和集成电路的发展紧密相关。半导体硅材料自从60年代被广泛应用于各类电子元器件以来，其用量平均大约以每年12-16%的速度增长。目前全世界每年消耗约18000-25000吨半导体级多晶硅，消耗6000-7000吨单晶硅，硅片销售金额约60-80亿美元。可以说在未来30-50年内，硅材料仍将是LSI工业最基础和最重要的功能材料。电子工业的发展历史表明，没有半导体硅材料的发展，就不可能有集成电路、电子工业和信息技术的发展。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网以及国内外多种相关报刊杂志媒体提供的最新研究资料。本报告对国内外行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对行业上下游行业的发展进行了探讨，是相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

报告目录

第一部分 行业运行现状

第一章 半导体材料行业发展综述

第一节 半导体行业定义及特征等

一、行业定义

二、行业发展进程

三、行业产品分类

四、行业特征分析

五、行业发展的意义

第二节 半导体行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒/退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

八、当前行业发展所属周期阶段的判断

第三节 半导体材料制备工艺

一、半导体材料提纯技术

二、半导体单晶制备工艺

三、半导体材料中杂质和缺陷的控制

第二章 2021-2026年半导体材料行业分析

第一节 全球半导体材料行业回顾

一、全球半导体材料市场概况

二、半导体材料市场需求反弹

三、全球半导体材料市场营收情况

第二节 2021-2026年中国半导体材料行业状况

一、中国半导体材料产业日益壮大

二、国内半导体材料企业技术水平和服务能力提升

三、国内半导体设备材料市场现状

四、半导体材料产业受政策大力支持

第三节 2021-2026年国内外半导体材料研发动态

一、Intel公司研发半导体新材料取得重大突破

二、德国成功研制有机薄膜半导体新材料

三、国内n型有机半导体材料研究获新进展

四、中科院与山东大学合作研究多功能有机半导体材料

第四节 半导体材料行业面临的形势及发展前景分析

- 一、市场需求推动半导体材料创新进程
- 二、国内半导体材料企业加快技术创新步伐
- 三、半导体材料未来发展趋势分析
- 四、中国半导体材料产业发展前景展望
- 五、2026-2031年中国半导体材料行业发展预测

第二部分 行业发展分析

第三章 2021-2026年半导体硅材料产业分析

第一节 2021-2026年半导体硅材料行业概述

- 一、世界各国均重视半导体硅材料行业发展
- 二、国内硅材料企业增强竞争力需内外兼修
- 三、发展我国高技术硅材料产业的建议

第二节 多晶硅

- 一、国际多晶硅产业概况
- 二、全球多晶硅产量状况
- 三、中国多晶硅行业分析
- 四、国内多晶硅市场现状
- 五、中国应重视多晶硅核心技术研发
- 六、国内多晶硅行业将迎来整合浪潮

第三节 单晶硅

- 一、单晶硅的特性简介
- 二、国际单晶硅市场概况

三、中国单晶硅市场探析

四、国内18英寸半导体级单晶硅棒投产

第四节 硅片

一、国际硅片市场概况

二、全球硅片价走势分析

三、2021-2026年全球硅片市场动态

四、中国硅片市场发展解析

五、450mm硅片市场研发及投资潜力分析

第五节 半导体硅材料及其替代品发展前景分析

一、我国半导体硅材料行业发展机遇分析

二、各国企业积极研发替代硅的半导体材料

三、石墨纳米带可能取代硅材料位置

第四章 2021-2026年第二代半导体材料产业的发展

第一节 砷化镓

一、砷化镓材料简介

二、砷化镓材料的主要特性

三、砷化镓材料与硅材料特性对比研究

第二节 2021-2026年国内外砷化镓产业分析

一、砷化镓材料产业的主要特点

二、国外砷化镓材料技术研发概况

三、国内砷化镓材料产业状况

四、国内砷化镓材料生产技术及发展趋势

五、发展我国砷化镓材料产业的建议

六、中国砷化镓材料行业战略思路

第三节 2021-2026年砷化镓市场应用及需求分析

一、砷化镓应用领域概述

二、砷化镓在微电子领域的应用分析

三、砷化镓在光电子领域的应用情况

四、砷化镓在太阳能电池行业的应用与发展分析

五、GaAs单晶市场和应用需求分析

六、砷化镓市场展望

第四节 磷化铟(InP)

一、磷化铟材料概述

二、磷化铟商业化生产面临难题

三、磷化铟材料应用前景分析

第三部分 行业竞争分析

第五章 2021-2026年第三代半导体材料市场运行状况

第一节 2021-2026年第三代半导体材料概述

一、第三代半导体材料发展概况

二、第三代半导体材料在LED产业中的发展和应用

第二节 碳化硅(SiC)

一、SiC材料的性能及制备方法

二、国内碳化硅晶片市场状况

三、SiC半导体器件及其应用情况

四、国内外SiC器件研发新成果

第三节 氮化镓(GaN)

一、GaN衬底技术新进展及应用

二、国内非极性GaN材料研究取得重要进展

三、GaN材料应用市场前景看好

第四节 2021-2026年宽禁带功率半导体器件发展分析

一、宽禁带功率半导体器件概述

二、碳化硅功率器件发展分析

三、氮化镓功率器件分析

四、宽禁带功率半导体器件行业展望

第六章 2021-2026年半导体材料下游行业分析

第一节 半导体行业

一、全球半导体产业发展状况

二、中国半导体业发展状况

三、半导体行业需转变经营模式

四、低碳经济助推半导体市场新一轮发展

五、半导体产业对上游材料市场需求加大

第二节 半导体照明行业

一、国内外半导体照明产业概况

二、中国半导体照明行业发展势头良好

三、中国半导体照明产业面临的挑战分析

四、上游原材料对半导体照明行业的影响分析

第三节 太阳能光伏电池产业

- 一、中国光伏产业现状
- 二、国内光伏市场需求尚未开启
- 三、光伏产业理性发展分析
- 四、晶硅电池仍将是太阳能光伏主流产品
- 五、多晶硅在太阳能光伏行业的应用前景分析

第七章 2021-2026年半导体材料行业重点企业分析

第一节 有研半导体材料股份有限公司

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、企业发展战略

第二节 天津中环半导体股份有限公司

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、企业发展战略

第三节 峨眉半导体材料厂

- 一、企业发展概况
- 二、发展成就回顾

三、品牌发展道路

四、工艺突破进展

第四节 四川新光硅业科技有限责任公司

一、企业发展概况

二、发展成就回顾

三、品牌发展道路

四、工艺突破进展

第五节 洛阳中硅高科技有限公司

一、企业发展概况

二、发展成就回顾

三、品牌发展道路

四、工艺突破进展

第六节 东莞市协创复合材料有限公司

一、企业发展概况

二、发展成就回顾

三、品牌发展道路

四、工艺突破进展

第七节 北京世纪金光半导体有限公司

一、企业发展概况

二、发展成就回顾

三、品牌发展道路

四、工艺突破进展

第八节 宁波立立电子股份有限公司

一、企业发展概况

二、发展成就回顾

三、品牌发展道路

四、工艺突破进展

第九节 宁波康强电子股份有限公司

一、企业发展概况

二、发展成就回顾

三、品牌发展道路

四、工艺突破进展

第十节 南京国盛电子有限公司

一、企业发展概况

二、发展成就回顾

三、品牌发展道路

四、工艺突破进展

第八章 2021-2026年中国半导体材料行业主要数据监测分析

第一节 2021-2026年中国半导体材料行业规模分析

一、工业销售产值分析

二、出口交货值分析

第二节 2021-2026年中国半导体材料行业结构分析

一、半导体材料企业结构分析

二、半导体材料行业从业人员结构分析

第三节 2021-2026年中国半导体材料行业关键性财务指标分析

一、行业主要盈利能力分析

二、行业主要偿债能力分析

三、行业主要运营能力分析

第九章 半导体材料行业替代品及互补产品分析

第一节 半导体材料行业替代品分析

一、替代品种类

二、主要替代品对半导体材料行业的影响

三、替代品发展趋势分析

第二节 半导体材料行业互补产品分析

一、行业互补产品种类

二、主要互补产品对半导体材料行业的影响

三、互补产品发展趋势分析

第十章 半导体材料产业渠道分析

第一节 2021-2026年国内半导体材料产品的经销模式

第二节 半导体材料行业渠道格局

第三节 半导体材料行业渠道形式

第四节 半导体材料渠道要素对比

第五节 半导体材料行业国际化营销模式分析

第六节 2021-2026年国内半导体材料产品生产及销售投资运作模式分析

第四部分 行业发展前景

第十一章 2026-2031年半导体材料行业发展前景预测分析

第一节 半导体材料行业投资价值分析

- 一、2026-2031年国内半导体材料行业盈利能力分析
- 二、2026-2031年国内半导体材料行业偿债能力分析
- 三、2026-2031年国内半导体材料行业运营能力分析
- 四、2026-2031年国内半导体材料产品投资收益率分析预测

第二节 2026-2031年国内半导体材料行业投资机会分析

- 一、国内强劲的经济增长对半导体材料行业的支撑因素分析
- 二、下游行业的需求对半导体材料行业的推动因素分析
- 三、半导体材料产品相关产业的发展对半导体材料行业的带动因素分析

第三节 2026-2031年中国半导体材料行业供需预测

- 一、2026-2031年中国半导体材料行业供给预测
- 二、2026-2031年中国半导体材料行业需求预测

第四节 2026-2031年中国半导体材料行业运行状况预测

- 一、2026-2031年半导体材料行业工业总产值预测
- 二、2026-2031年半导体材料行业销售收入预测

第十二章 2026-2031年中国半导体材料行业投资风险分析

第一节 中国半导体材料行业存在问题分析

第二节 中国半导体材料行业上下游产业链风险分析

- 一、下游行业需求市场风险分析
- 二、关联行业风险分析

第三节 中国半导体材料行业投资风险分析

- 一、政策和体制风险分析

二、技术发展风险分析

三、原材料风险分析

四、进入/退出风险分析

五、经营管理风险分析

第十三章 2026-2031年中国半导体材料行业发展策略及投资建议

第一节 半导体材料行业发展战略规划背景意义

一、行业转型升级的需要

二、行业强做大做的需要

三、行业可持续发展需要

第二节 半导体材料行业战略规划制定依据

一、行业发展规律

二、企业资源与能力

三、可预期的战略定位

第三节 半导体材料行业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 半导体材料行业市场的重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第五节 中道泰和行业投资建议

一、行业投资方向建议

二、行业投资方式建议

图表目录

图表：2021-2026年全球半导体材料行业市场规模及增速

图表：2026-2031年全球半导体材料行业市场规模及增速预测

图表：2021-2026年国内生产总值及其增长速度

图表：2021-2026年社会消费品零售总额及其增长速度

图表：2021-2026年中国半导体材料行业市场规模分析

图表：2021-2026年我国半导体材料行业出口分析

图表：我国半导体材料行业出口结构分析

图表：2026-2031年我国半导体材料行业进口预测

图表：2026-2031年我国半导体材料行业出口预测

图表：2021-2026年我国半导体材料行业子行业产量分析

图表：2026-2031年我国半导体材料行业子行业产量预测

图表：2026-2031年我国半导体材料行业需求量预测

图表：半导体材料渠道策略示意图

图表：半导体材料产业链投资示意图

图表：2026-2031年半导体材料行业工业总产值预测

图表：2026-2031年半导体材料行业销售收入预测

图表：2026-2031年半导体材料行业总资产预测

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：64663

本文地址：<https://www.51baogao.cn/bg/20170406/64663.shtml>

在线订购：[点击这里](#)